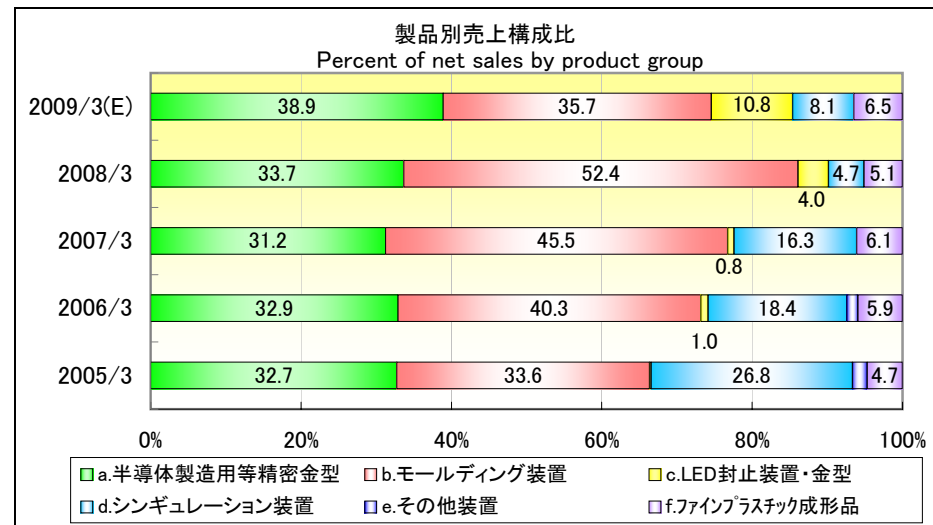


2009年3月期 第2四半期決算補足資料 (2008年11月)



I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)



決算期		2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3(E)
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions					
売上高	①Net sales	24,111	19,641	25,159	25,753	18,500
営業利益	Operating income	402	-3,012	1,224	2,381	-1,000
経常利益	Ordinary income	326	-2,778	1,289	2,125	-1,150
当期純利益	Net income	146	-5,923	1,038	2,118	-1,250
総資産	Total assets	38,343	36,602	34,925	34,360	—
純資産	Net assets	15,998	13,003	14,941	16,394	—
1株当たり指標	Per share data					
1株当たり当期純利益	Net income per share	7.04	-275.58	41.59	84.70	-49.97
諸指標	Data					
自己資本当期純利益率	Return on equity	0.9	-40.8	7.4	13.5	-8.1
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	0.9	-7.4	3.6	6.1	—
売上高営業利益率	②Operating income to net sales	1.7	-15.3	4.9	9.2	-5.4
自己資本比率	Equity ratio	41.7	35.5	42.8	47.7	—

(単位: 百万円/¥Millions)

	2007/9	2008/9
売上高	11,460	8,527
営業利益	803	-1,001
経常利益	824	-1,116
当期純利益	885	-1,238
総資産	33,594	32,617
純資産	15,971	14,574
1株当たり当期純利益	35.41	-49.49
自己資本当期純利益率	5.7	-8.0
総資産経常利益率	2.4	-3.3
売上高営業利益率	7.0	-12.3
自己資本比率	47.5	44.7

増減率	Percent change	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3(E)
決算期						
売上高	Net sales	33.2	-18.5	28.1	2.4	-28.2
営業利益	Operating income	-10.5	—	—	94.5	—
経常利益	Ordinary income	-2.7	—	—	64.8	—
当期純利益	Net income	—	—	—	104.0	—

	2007/9	2008/9
売上高	-7.2	-25.6
営業利益	43.6	—
経常利益	56.0	—
当期純利益	121.5	—

※a.Precision molds

b.Semiconductor plastic encapsulation systems

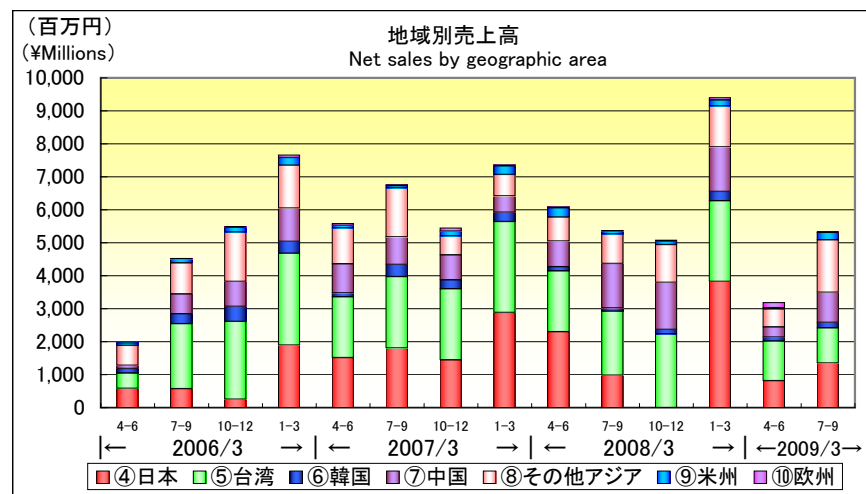
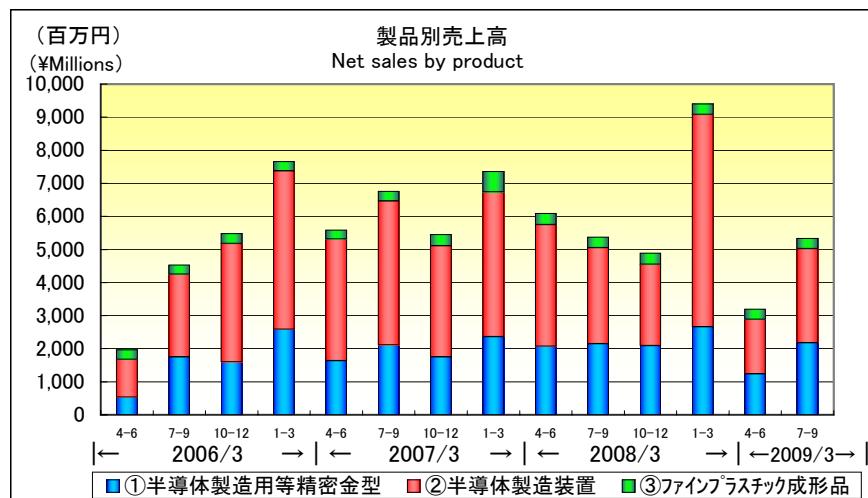
c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED

d.Signature parts and systems

e.Others

f.Engineering plastic molded products

II. 四半期売上動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



※ 従来半導体製造用等精密金型に分類していたシンギュレーション金型部品を半導体製造装置に含めて表示しております。

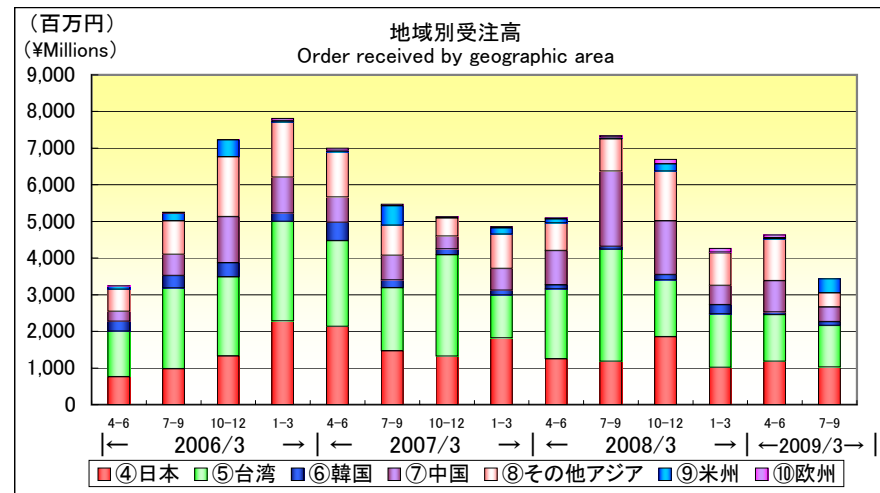
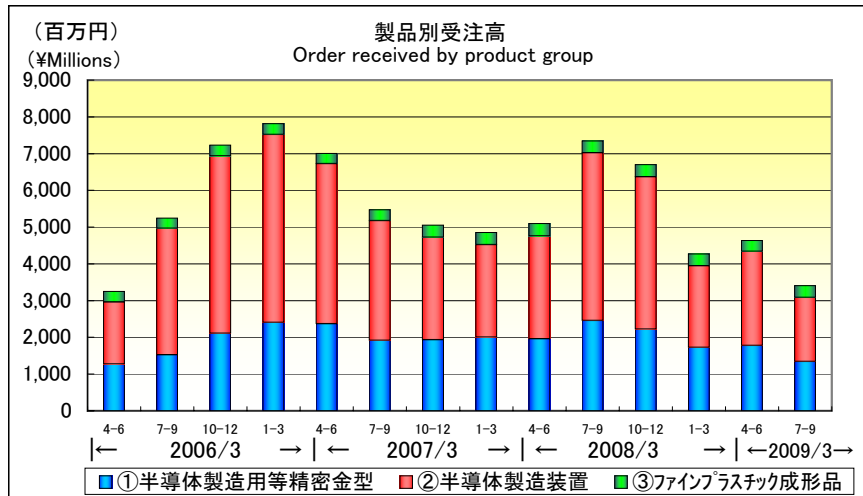
製品別売上高 Net sales by product group

決算期	2006/3					2007/3					2008/3					2009/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	1,970	4,528	5,483	7,659	19,641	5,589	6,756	5,451	7,362	25,159	6,090	5,369	4,894	9,398	25,753	3,192	5,335	8,527
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	531	1,751	1,598	2,588	6,462	1,633	2,112	1,755	2,359	7,861	2,073	2,149	2,087	2,660	8,970	1,242	2,174	3,417
半導体製造装置 ② Semiconductor manufacturing equipment	1,144	2,494	3,581	4,788	12,017	3,680	4,351	3,355	4,379	15,766	3,681	2,901	2,461	6,425	15,469	1,646	2,852	4,499
ファインプラスチック成形品 ③ Engineering plastic molded products	294	281	302	282	1,161	275	293	341	622	1,531	336	319	345	312	1,313	302	307	610
月平均	657	1,509	1,828	2,553	1,637	1,863	2,252	1,817	2,454	2,097	2,030	1,789	1,631	3,132	2,146	1,064	1,778	1,421

地域別売上高 Net sales by geographic area

決算期	2006/3					2007/3					2008/3					2009/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	1,970	4,528	5,483	7,659	19,641	5,589	6,756	5,451	7,362	25,159	6,090	5,369	4,894	9,398	25,753	3,192	5,335	8,527
日本 ④ Japan	581	571	254	1,896	3,302	1,519	1,805	1,447	2,880	7,653	2,300	983	-186	3,826	6,924	820	1,347	2,167
アジア太平洋 Asia pacific	1,302	3,814	5,069	5,458	15,644	3,927	4,858	3,762	4,192	16,742	3,477	4,283	4,941	5,318	18,020	2,177	3,740	5,917
(内 台湾) ⑤ Taiwan	463	1,976	2,362	2,779	7,582	1,842	2,165	2,157	2,761	8,927	1,841	1,944	2,237	2,443	8,465	1,195	1,067	2,263
(内 韓国) ⑥ Korea	143	300	450	368	1,262	117	366	272	283	1,040	131	89	130	287	639	118	166	284
(内 中国) ⑦ China	97	604	762	1,001	2,465	884	840	751	493	2,969	781	1,350	1,425	1,351	4,908	309	919	1,228
(内 その他アジア) ⑧ Other asia	597	933	1,494	1,309	4,333	1,084	1,486	580	654	3,805	722	899	1,148	1,235	4,006	553	1,587	2,140
米州 ⑨ America	76	120	147	233	578	74	64	146	258	543	284	83	97	188	654	31	226	257
欧州 ⑩ Europe	9	22	12	70	115	66	28	94	31	220	28	19	41	65	154	163	21	184

Ⅲ. 四半期受注動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



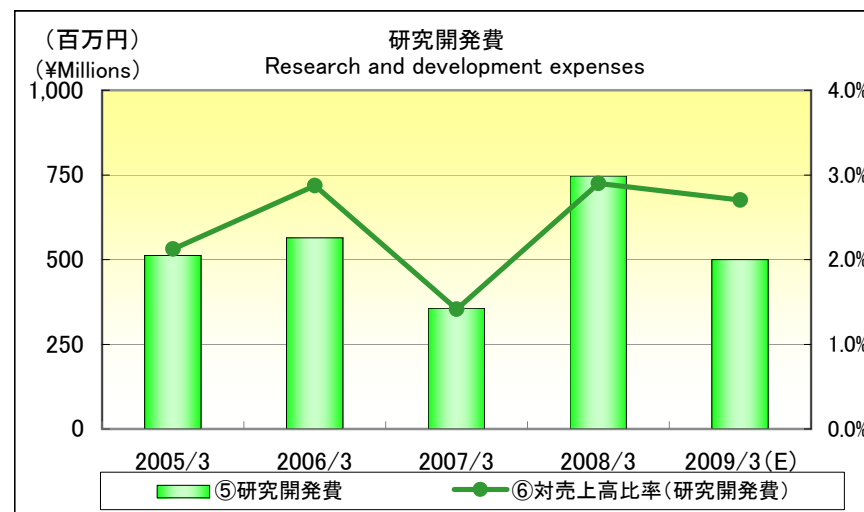
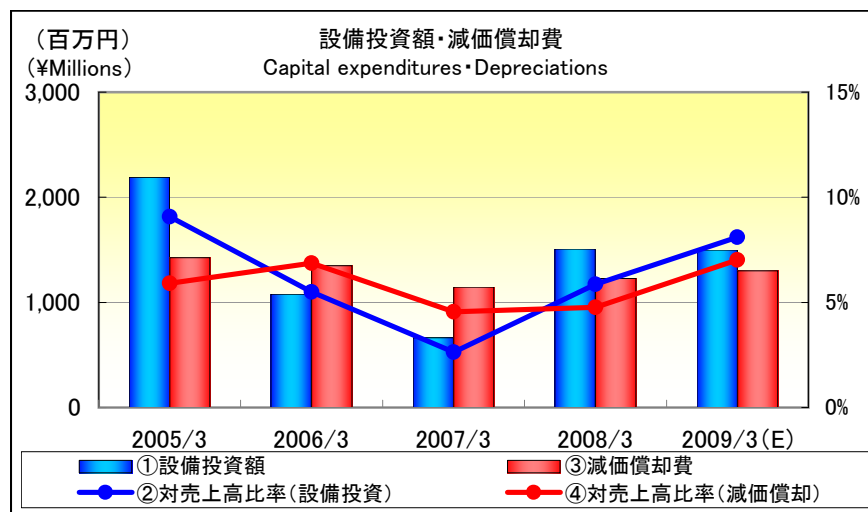
※ 従来半導体製造用等精密金型に分類していましたが、シンギュレーション金型部品を半導体製造装置に含めて表示しております。
製品別受注高 Order received by product group

決算期	2006/3					2007/3					2008/3					2009/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	3,249	5,247	7,237	7,814	23,547	7,004	5,475	5,051	4,857	22,388	5,097	7,345	6,697	4,268	23,410	4,635	3,410	8,046
半導体製造用等精密金型																		
① Precision molds	1,273	1,527	2,110	2,406	7,318	2,369	1,917	1,938	2,006	8,232	1,964	2,453	2,219	1,725	8,362	1,777	1,345	3,123
半導体製造装置																		
② Semiconductor manufacturing equipment	1,685	3,442	4,828	5,110	15,068	4,359	3,254	2,783	2,516	12,915	2,790	4,573	4,149	2,225	13,739	2,561	1,738	4,300
ファインプラスチック成形品																		
③ Engineering plastic molded products	290	276	297	295	1,161	275	302	328	333	1,241	342	318	328	318	1,308	296	326	623
月平均	1,083	1,749	2,412	2,605	1,962	2,335	1,825	1,684	1,619	1,866	1,699	2,448	2,232	1,422	1,951	1,545	1,137	1,341

地域別受注高 Order received by geographic area

決算期	2006/3					2007/3					2008/3					2009/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	3,249	5,247	7,237	7,814	23,547	7,004	5,475	5,051	4,857	22,388	5,097	7,345	6,697	4,268	23,410	4,635	3,410	8,046
日本 ④ Japan	763	982	1,331	2,283	5,361	2,133	1,465	1,322	1,821	6,742	1,249	1,176	1,854	1,015	5,295	1,178	1,024	2,203
アジア太平洋 Asia pacific	2,384	4,032	5,433	5,427	17,277	4,760	3,432	3,770	2,826	14,788	3,706	6,078	4,515	3,125	17,425	3,339	2,026	5,365
(内 台湾) ⑤ Taiwan	1,242	2,199	2,155	2,717	8,314	2,337	1,724	2,767	1,164	7,994	1,909	3,063	1,548	1,459	7,981	1,277	1,135	2,412
(内 韓国) ⑥ Korea	267	341	389	229	1,227	498	214	158	131	1,002	108	81	143	253	586	70	100	171
(内 中国) ⑦ China	267	578	1,251	975	3,072	698	671	345	600	2,316	935	2,054	1,471	525	4,986	854	404	1,258
(内 その他アジア) ⑧ Other asia	606	915	1,636	1,505	4,663	1,226	821	498	929	3,475	753	878	1,351	887	3,871	1,136	386	1,523
米州 ⑨ America	92	203	464	38	799	49	528	-78	177	677	113	41	202	17	375	39	386	426
欧州 ⑩ Europe	8	30	7	64	109	60	50	36	32	179	28	50	124	110	313	78	-27	51

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidate)



(連結) (Consolidated)		2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3(E)
決算期						
キャッシュフロー	Cash flows					
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	-2,571	-166	1,894	2,587	—
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-1,883	-1,548	252	-1,083	—
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	3,947	2,232	-2,203	-1,947	—
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents at	2,959	3,588	3,542	3,351	—
設備投資額	①Capital expenditures	2,189	1,079	663	1,508	1,500
対売上比率	②Ratio of sales	9.08	5.49	2.64	5.86	8.11
減価償却費	③Depreciations	1,425	1,349	1,144	1,227	1,300
対売上比率	④Ratio of sales	5.91	6.87	4.55	4.76	7.03
研究開発費	⑤Research and development expenses	512	564	356	747	500
対売上比率	⑥Ratio of sales	2.13	2.87	1.42	2.90	2.70

(単位: 百万円/¥Millions)

	2007/9	2008/9
	1,293	-397
	-623	-728
	-1,236	1,351
	2,970	3,499
	534	468
	4.66	5.49
	590	643
	5.15	7.54
	400	177
	3.49	2.08